

组合式连接器(适应SD内存卡, MultiMediaCard™, Memory Stick™, xD-Picture Card™)

SCDG4系列



双响键排出式, 支持4种媒体。



SD内存卡用
microSD™卡用
SIM卡8销用
Memory Stick Micro™用

组合式

W-SIM用

主要规格

项目		规格	
构造	合适的媒体	SD Memory Card	
		MultiMediaCard™	
		Memory Stick™	
		xD-Picture Card™	
	贴装方式	表面贴装型	
	贴装状态	标准贴装	
	媒体排出方式	双响键式	
性能	使用温度范围	-10°C to +60°C	
	耐高压	100V AC 1minute	
	绝缘电阻(初期)	1,000MΩ min.	
	接触电阻(初期)	连接接点	200mΩ max.
		感知开关	600mΩ max.
插拔回数	5,000cycles		

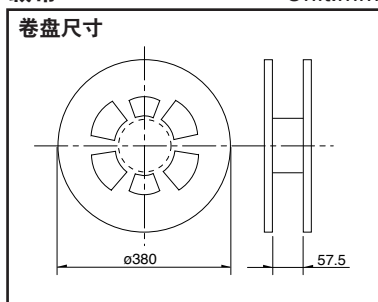
产品一览

媒体排出方式	贴装状态	基准距(mm)	包装状态	产品编号
双响键式	标准贴装	0	载带	SCDG4B0100

包装规格

载带

Unit:mm



包装数(pcs.)			载带宽度(mm)	出口包装箱尺寸(mm)
1卷	1箱/日本	1箱/出口包装		
300	600	1,200	56	403 × 403 × 297

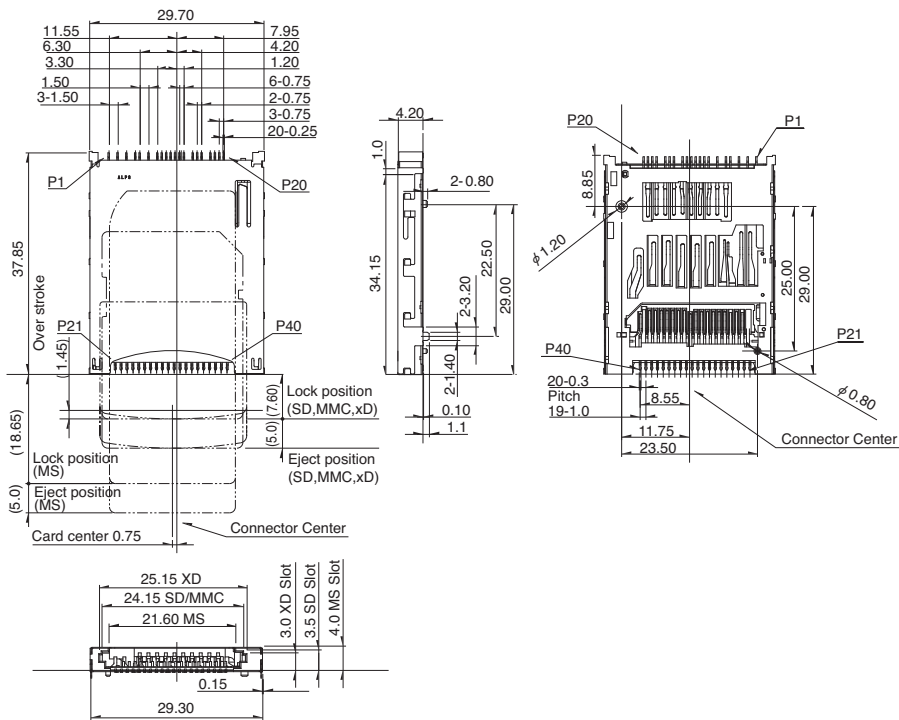
注

请以最小订购单位的N(整数)倍来订货。

外形图

Unit:mm

形状



SD内存卡用

microSD™卡用

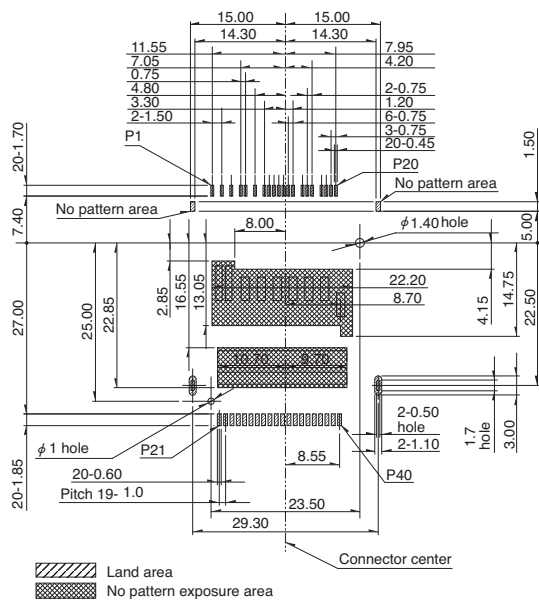
SIM卡8销用

Memory Stick Micro™用


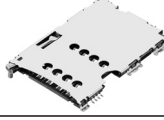


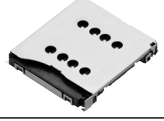


组合式

W-SIM用

印刷电路板安装孔尺寸图 (从贴装面看)



产品系列一览

合适的媒体	产品编号	产品照片	媒体 排出方式	贴装状态	特长	基准距 (mm)	车用 产品	页
SIM卡 8销	SCGC1B0101			标准贴装	带开关	0	○	541
	SCGC1B0301				带自动凸轮锁			
Memory Stick Micro™	SCNA1A0300							543
组合式	SD 内存卡 MultiMedia Card™ Memory Stick™	SCDB3A0202	双响键式	标准贴装	没有突起	0	—	545
		SCDB4A0101		反面贴装				
	SD内存卡 MultiMedia Card™ Multi-Media Card Plus™	SCDG1A0101	标准贴装	547				
		SCDG2A0101	反面贴装					
	SD内存卡 MultiMedia Card™ Memory Stick™ xD-Picture Card™	SCDG4B0100			薄型，厚度 4.2mm			549
	microSD™卡 SIM卡 8销	SCHG1B0100		双响键式 手插拔式	microSD™卡 右插入型			551
	W-SIM	SCZA1A0100		双响键式	标准贴装			没有突起L型
SCZA1A0200		有突起L型						
SCZA1A0300		没有突起0.6mm型						
SCZA1A0400		有突起0.6mm型						
SCZA1A0500		没有突起1.2mm型						
SCZA1A0600		有突起1.2mm型						
SCZA2A0100		手插拔式	有突起L型					
SCZA2A0200		没有突起 0.6mm型						

SD内存
卡用microSD™
卡用SIM卡
8销用Memory Stick
Micro™用

组合式

W-SIM用

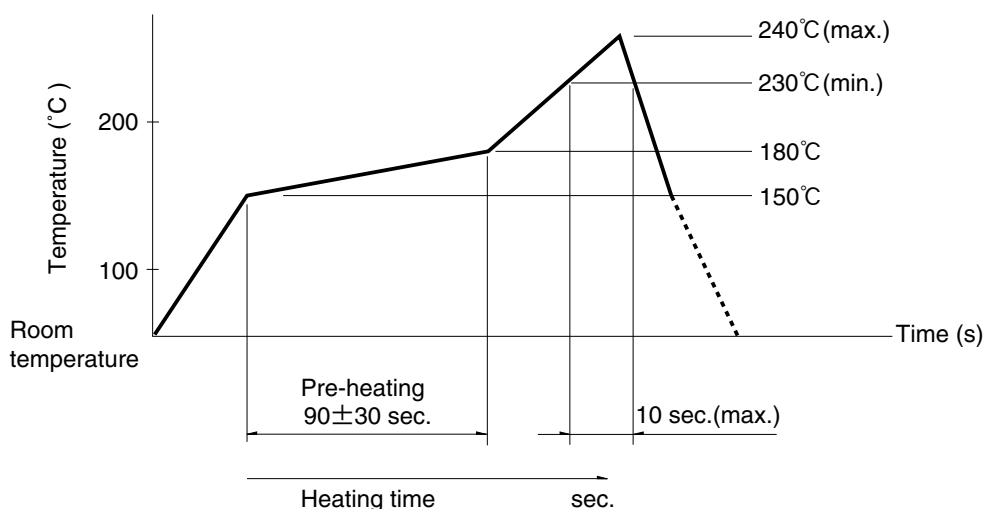
注

支持车载产品栏中的○符号表示，系列内部分产品可在-40℃~+85℃的温度范围内工作。

焊锡条件

回流方式的参考举例

1. 加热方式 为热风循环的上下加热方式。
2. 温度测量方式 使用 $\phi 0.1 \sim \phi 0.2$ 的CA(K)或CC(T)测量。固定方式采用耐热胶带。
3. 温度分布(产品表面)。



请根据各产品的产品规格书确认温度曲线。

使用本产品时的注意事项

1. 连接器使用时的注意事项
 - (1) 避免助熔剂从连接器上面侵入内部。
 - (2) 本产品设计时以清洗为前提，若进行清洗，可能导致电气及机械特性劣化。若要进行清洗，请提前与本公司联系。
2. 焊接端子因承受负载可能导致松动、变形及电气特性劣化。
3. 焊锡时，若使用水溶性助熔剂，可能腐蚀产品，因此应避免使用水溶性助熔剂。
4. 回流条件的设置请根据实际的批量生产条件进行确认。
5. 因印刷线路板翘曲可能使产品特性发生变化，因此进行图案设计及布局设计时应对其充分考虑。
6. 不要在推杆压入位置进行焊锡作业。
7. 为防止接点部位、端子部位的硫化及氧化等现象导致接触故障或形成皮膜而使得焊锡特性劣化，应做到以下几点：
 - 避免将产品保存在超过60°C的高温高湿及可能产生硫磺、氯气类等腐蚀性气体的场所，避免堆积过高。
 - 连接器应在未开封状态下保存于常温常湿环境中，保存期限为收货后三个月内，最迟应在六个月内使用。
 - 开封后，应当使用塑料袋密封且保存于避免阳光直射的阴凉处，并尽早使用。
8. 不可对连接器上面的金属盒用力或进行挤压，否则可能导致卡片无法弹出或影响产品的其他性能。
9. 为防止开关ON/OFF切换动作时的回弹及外部振动等震颤导致的误动作，应做到以下几点：
 - 进行多次读入。
 - 设置延迟时间，推荐为400msec以上。
 - 设置CR积分电路。
10. 本产品中若使用非指定规格的卡片时，可能导致其无法正常工作。

SD内存卡用

microSD™卡用

SIM卡8销用

Memory Stick Micro™用

组合式

W-SIM用